



英屬開曼群島商

虹揚發展科技股份有限公司

HY Electronic (Cayman) Limited



| We Power The Future

2026Q1 虹揚科技法人說明會

主講者：發言人 程御峰 總經理

股票代碼：6573

大綱

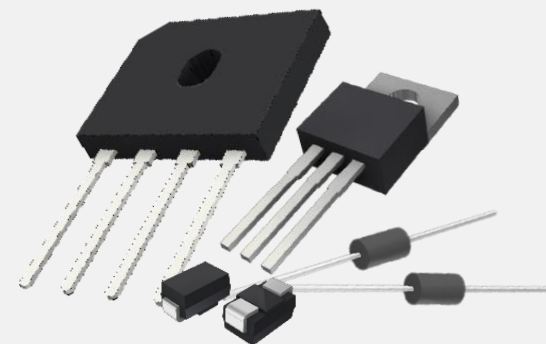
01 營運成果

02 產品組合銷售

03 產品藍圖

04 營運總結

05 Q&A



01

營運成果



簡明合併綜合損益表

單位：新台幣 仟元	2026Q1		2025Q1		2025		2024	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	177,165	100	230,728	100	833,212	100	962,465	100
營業成本	157,554	89	212,677	92	738,527	89	930,217	97
營業毛利	19,611	11	18,051	8	94,685	11	32,248	3
營業費用	48,829	27	52,417	23	196,370	24	210,809	21
營業淨利(損)	(29,218)	-16	(34,366)	-15	(101,685)	-13	(178,561)	-18
營業外收入及支出	(1,577)	-2	(2,953)	-2	211,548	26	139,444	14
稅前淨利(損)	(30,795)	-18	(37,319)	-17	109,863	13	(39,117)	-4
本年度淨利(損)	(31,094)	-18	(38,232)	-17	98,973	12	(77,001)	-8
每股盈餘(元)	-0.40		-0.48		1.23		-1.94	



簡明合併資產負債表

單位：新台幣 仟元

	2026Q1		2025		2024	
	金額	%	金額	%	金額	%
總資產	1,742,505	100	1,807,881	100	2,025,214	100
流動資產	593,681	33	650,058	36	740,152	37
非流動資產	1,148,824	67	1,157,823	64	1,285,062	63
總負債	1,060,888	61	1,110,737	61	1,026,800	51
流動負債	844,611	49	880,047	48	947,831	47
非流動負債	216,277	12	230,690	13	78,969	4
權益總計	681,617	39	697,144	39	998,414	49



季度營收表現

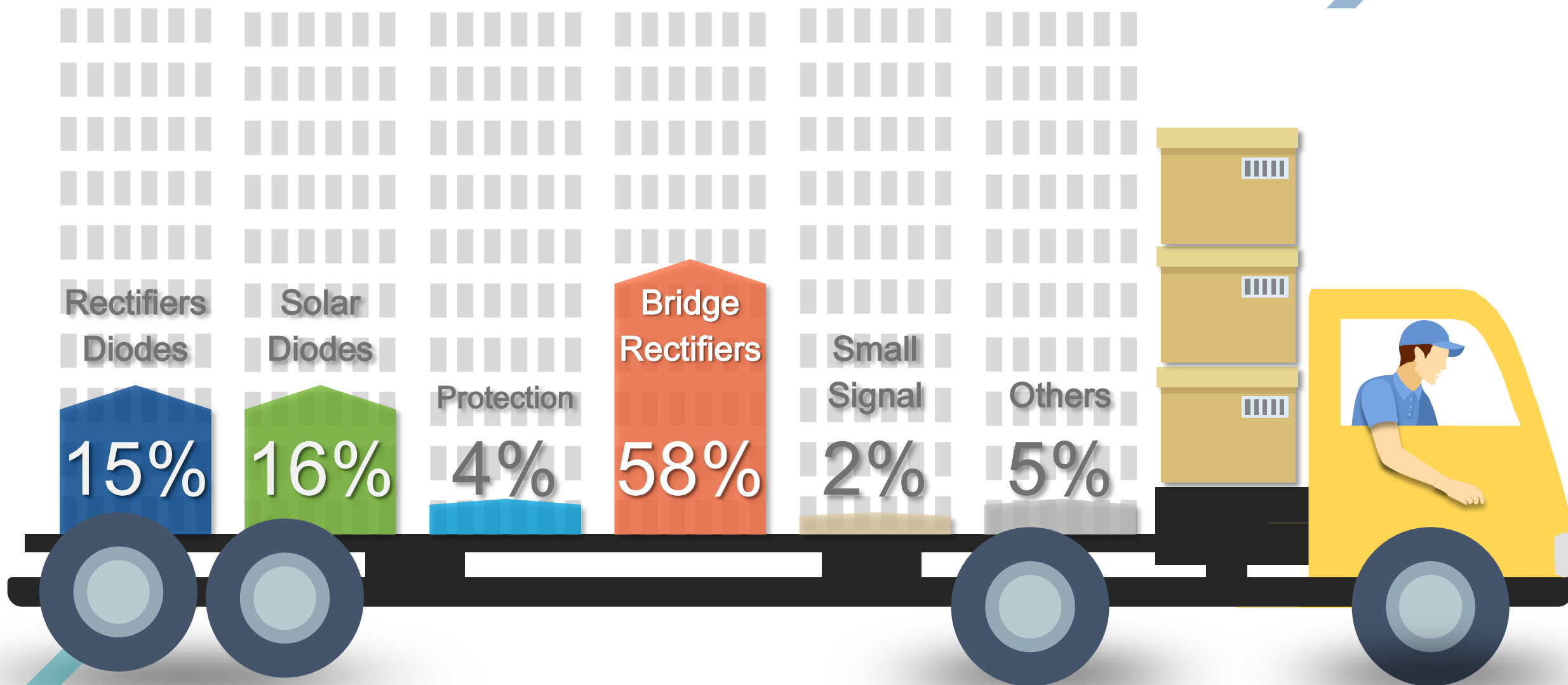


02

產品組合銷售



銷售分析-產品別

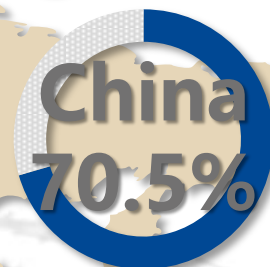




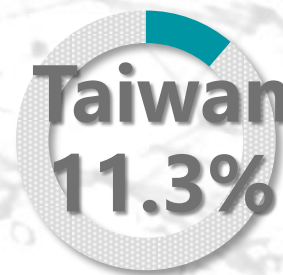
銷售分析-地區別



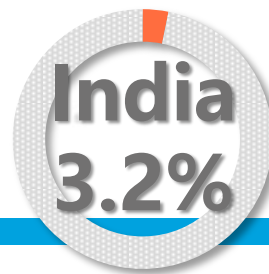
義大利



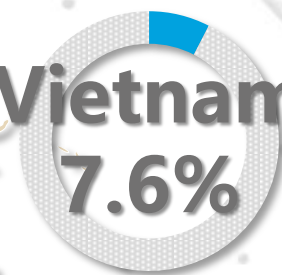
中國



台灣



印度



越南



銷售分析-產業別

AI伺服器

6%



工業自動化

15%



車用

4%



綠能

16%



5G

29%



電源模組

16%



其他

14%



03

產品藍圖



產品發展藍圖



2026

2027

2028



□ Planar Low VF Bridge VF 0.87V@IF

GBU/GBJ 600V / 10A-35A
4GBJ 600V / 10A-25A
2GBJ 600V / 10A

□ TVS TO-263 6600W

□ Low VF Trench Schottky

TO/ITO/SMA/SMB/SMC
45V-200V / 3A-60A

□ Planar Schottky 250V TO/ITO 10A-60A

□ High power 3-Phase Bridge

SKBPC 1000V-1600V / 75A

□ SiC SBD 650V / 4A-20A

□ Power GBU Package

GBUP 50V-1600V / 15A-35A

□ GBJ 1000V-1600V / 60A

□ 4GBJ 1000V-1600V / 35A

□ TVS 800W

DFN3719 / Uni / 13V

□ ESD CSP0603

Low Cj / Bi / 1V / Ipp=7A

□ S.S-Schottky

SOD-323F 30V-40V / 0.1A-0.5A

□ S.S-Switch SOD-123 / SOT-23

75V-250V / 0.15A-0.2A

□ Planar Low VF Bridge VF 0.89V@IF

GBU/GBJ 800V / 10A-35A
4GBJ 800V / 10A-25A
2GBJ 800V / 10A

□ Power SGBJ

SGBJP / 50A-1600V / 35A-50A

□ Power HGBJ

HGBJP / 50V-1600V / 35A-50A

□ Power GBJ

GBJP / 1000V-1600V / 60A

□ Planar Schottky 300V

TO/ITO 300V / 10A-60A

□ SiC 1200V SBD 4A~20A

□ ESD High surge

SOT-26 / Bi / 3.3V-5V / 20A-24A

□ Auto ESD DFN1006 / DFN0603

Bi / 1.8V-27V / 5A-12A

□ Power Clip TO/ITO

200V-300V / 10A-30A

□ Package SOT227

100V-200V / 100A-150A

□ SiC Mosfet 650V

□ SiC Mosfet 1200V

□ TVS SMC

8.0SMDJ Series / 8KW

04

營運總結



2025營運總結



供應鏈整合

透過內外部整合、供應鏈分散分險以降低單一風險，構建跨區域產能要求，以滿足客戶「在地製造」需求。



布局多元化產品

新市場應用興起，技術與供應鏈互補策略，建立關鍵高毛利產品，新產品/應用組合導入重點客戶，提供多樣化需求。



新興市場應用

虹揚積極布局車用與AI、伺服器算力這兩大核心支柱，高成長&長期趨勢明確能有效分散市場風險並強化長期競爭力。



05

Q&A



英屬開曼群島商

虹揚發展科技股份有限公司

HY Electronic (Cayman) Limited

THANK YOU FOR
YOUR LISTENING



Like us on
Facebook



加入好友



<https://www.hygroup888.com>

We Power The Future

免責聲明

- 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
- 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場風險、供應鏈、市場需求，以及本公司本公司所不可控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。